

177 (V, HH

特点:

- 频率范围: 0.002~6.0GHz
- 动态范围: 65dB@±1dB 误差 70dB@±3dB 误差
- 电源电压: +2.7V~+5.5V
- 快速瞬态响应: 10ns/20ns 上升/下降响应
- 支持片内温度补偿
- OFN 塑封
- 封装: 3.0mm×3.0mm×1.2mm

产品简介:

YDC8108-QP3 是一款 2MHz~6GHz 宽带高动态对数检波器,能够将射频输入信号精确地转换为相应的对数线性电压输出。典型动态范围为 65dB,误差小于±1dB、动态范围 70dB,误差小于±3dB。在快速检波模式下,上升/下降响应时间约为 10/20ns。

功能框图:

YDC8108-QP3 采用硅基工艺制造,采用 3.0mm×3.0mm×1.2mm 16 引脚 QFN 封装。电源电压支持+2.7~+5.5V。主要用于射频发射机自动功率控制,通信及雷达系统的信号强度指示,各种电子设备的功率监测等场景。

性能参数: (50Ω系统, -55℃~+125℃)

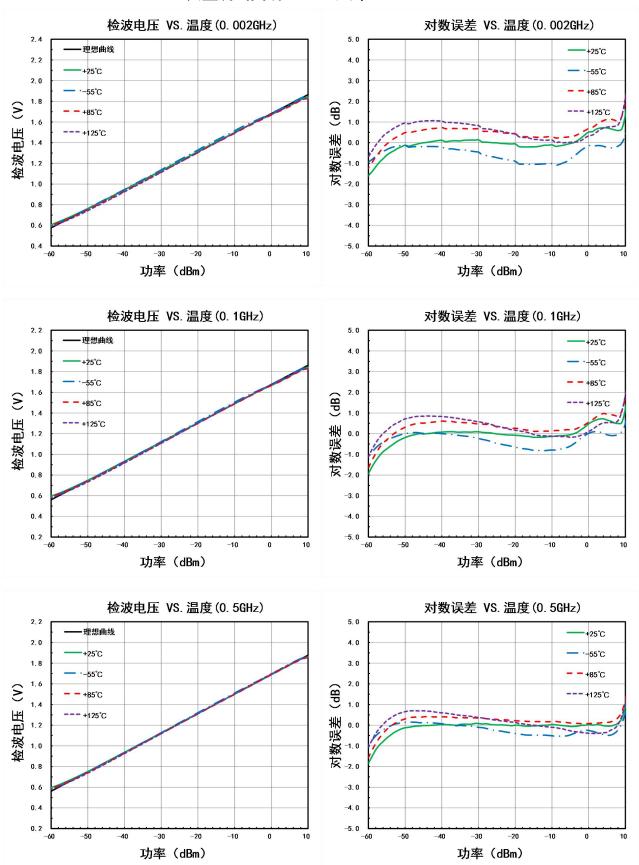
参数名称	符号	湖上春春山	参数值			34 A4	47.77
		测试条件	MIN	TYP	MAX	単位	备注
频率范围	f		0.002	-	6.0	GHz	-
输入功率范围	P _{IN}		-60	-	10	dBm	-
±1dB 动态范围	-		60	65	-	dB	-
±3dB 动态范围	-	f= 0.5GHz	65	70	-	dB	-
检波斜率	SLOPE		5	19	25	mV/dB	-
输入阻抗	R		-	2.4/0.4	-	KΩ/pF	额定值
电源电压	VD		+2.7	-	+5.5	V	-
工作由法	I_D	TADJ 悬空,工作状态	-	28	35	mA	-
工作电流		TADJ=VD,关断状态	-	0.15	0.5	mA	-
输出电压	Vout	VD=+5V, f=0.002~6GHz	0.3	-	2.0	V	典型应用
检波下降时间	t _{FALL}	CLPF 悬空 , 1us 脉宽	-	10	50	ns	-
检波上升时间	t _{RISE}	CLPF 悬空 , 1us 脉宽	-	20	50	ns	-

^{*:} 芯片均经过在片 100%直流与 RF 测试。

0.002~6.0GHz 对数检波器

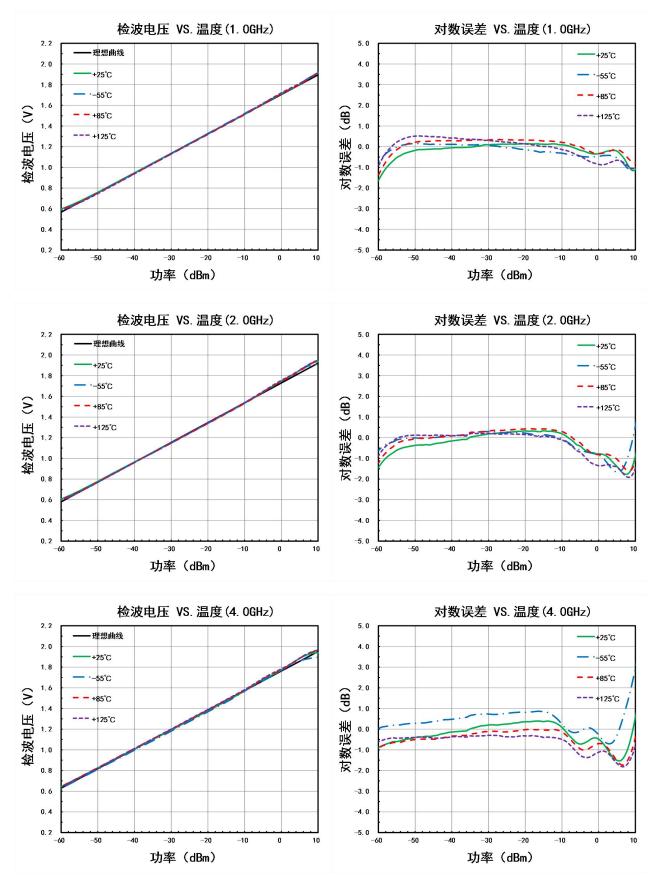
002505-V1 5

典型测试曲线: (50Ω系统, VD =+3.3V)



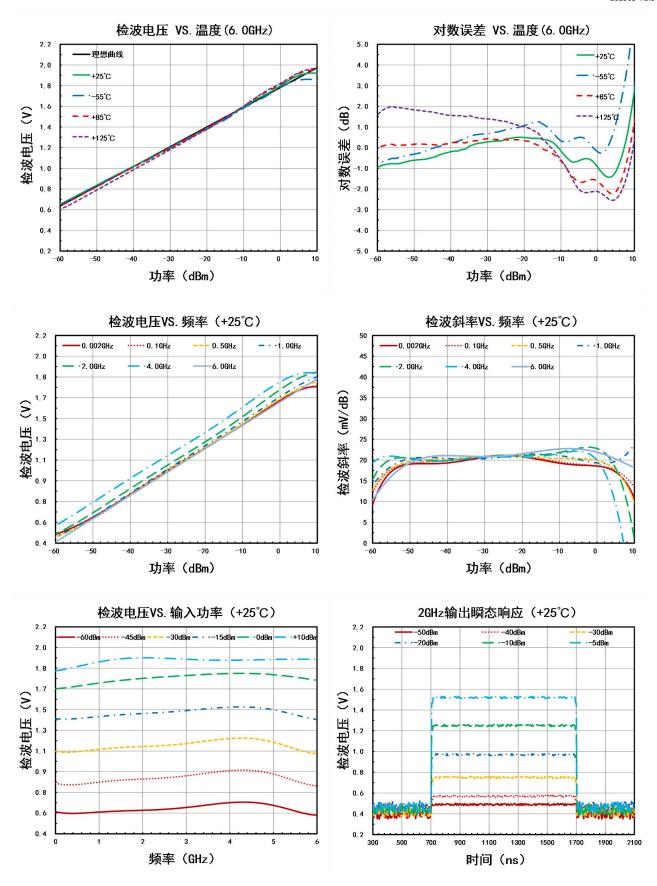
0.002~6.0GHz 对数检波器

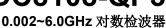
202505-V1.5



0.002~6.0GHz 对数检波器

202505-V1.5

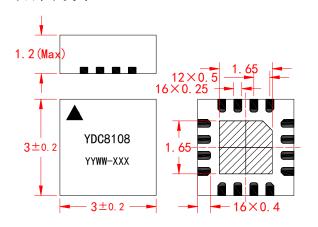




COSSESS VAL



外形尺寸图:



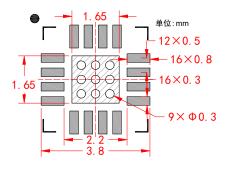
注: 1、单位: mm, 未注明公差按 GB/T 1804-m;

- 2、产品采用 3.0mm×3.0mm×1.2mm 16 引脚 QFN 塑封, 引脚表面镀镍钯金(Ni:0.5~2.0um, Pd:0.02~0.15um, Au:0.003~0.0025um);
 - 3、产品标识采用激光刻字。

字符标识:

1010		
标识	说明	备注
YDC8108	产品型号	
	1号引脚标识	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

推荐焊盘图:



引脚定义:

引脚编号	符号	描述		
1,4	VD	电源供电,+2.7V~+5.5V		
2	RFINN	射频输入负端,交流耦合到地		
3	RFINP	射频输入正端,交流耦合		
5/13/14/15	-	需悬空		
6	-	备份 LDO 接口,需悬空		
16	-	内部 LDO 输出端口,需悬空		
7	CLPFA	外接滤波电容, 可通过调整电容值		
		调整瞬态响应时间		
8	CLPFB	外接滤波电容, 可通过调整电容值		
•		调整瞬态响应时间		
9	VOUT	检波电压输出		
10	VSET	反馈输入,典型应用场景下直接连		
10	VSEI	接到 VOUT 输出端口		
11	GND	公共参考,接地		
12	TADJ	温度补偿调节, 典型应用场景下该		
		端口悬空;TADJ=VD 时,关断		
底部中央	GND	接地		
焊盘	GND	按 现		

极限参数表:

以收受权仪:				
参数名称	极限值			
输入射频功率	+15dBm			
电源电压	+6V			
装配温度	+260℃, 20s			
工作温度	-55∼+125℃			
贮存温度	-55∼+150°C			
潮湿敏感等级(MSL)	3			
静电放电敏感度等级	1A			

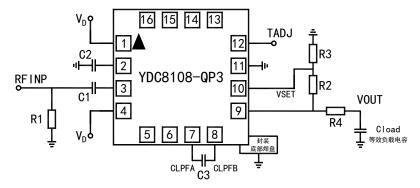
超过以上任何一项极限参数,可能造成器件永久损坏。







典型连接图:



注: 1、C3 与瞬态响应的关系为:

- ◆ 当 C3 不接,或 C3 电容值小于 1pF 时,瞬态响应时间小于 20nS;
- ◆ 当 C3 电容值大于 5pF 时,响应时间和电容 C3 满足以下关系: T=(C3/10pF)*100ns;
- 2、C3 与视频带宽的关系满足下式:

$$C3 = \frac{1}{A1} \times \left(\frac{Gm}{2\pi \times Video Bandwidth} - C_{FIX} \right)$$

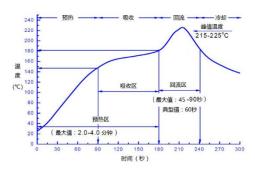
- ◆ 式中 Gm=2mS CFIX=6pF A1=15;
- ◆ 当 C3 不接时,视频带宽为 53MHz;

推荐应用电路器件值:

位号	型号/数值	备注	
C1、C2	47nF	耦合电容	
С3	/	Cload 等效负载电容<10pF 时,不接 Cload 等效负载电容>10pF 时,推荐 35*C3>Cload	
R1	52Ω	匹配电阻	
R2、R3	/	斜率调节电阻,满足公式 $R2/R3+1=Slop2/Slop1$ 其中 $Slop2$ 为调节后斜率, $Slop1$ 为默认斜率(该手册测试曲线展示斜率),例如当 $R2=R3=10$ K Ω 时,斜率翻倍;注意最大检波输出电压小于电源电压,即: $Vout < V_D$	
R4	/	典型应用场景下接 0 Ω 电阻	

产品使用注意事项:

- 1. 产品属于静电敏感器件,在运输、装配使用过程中请注意静电防护。
- 2. 产品属于3级潮湿敏感器件,产品在存储、操作、运输、包装使用过程须按IPC/JEDEC J-STD 相关要求执行。
- 3. 产品使用时请保证接地良好(GND引脚和底部金属化区域)。
- 4. 产品推荐 SMT 工艺贴片使用,采用 Sn63/Pb37 锡膏(熔点+183℃)回流焊接。





YDC8108-QP3

0.002~6.0GHz 对数检波器

202505-V1 5

此图为推荐回流温度曲线,因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线,实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

- 5. 如特殊情况产品需进行返工返修处理,在返工返修前应按 IPC/JEDEC J-STD MSL3 级要求对器件进行烘烤处理,避免返工返修过程加热对器件造成热损伤。回流及返工返修次数不大于 3 次。
- 6. 如特殊情况需采用手工补焊,烙铁温度+350℃,焊接时间不超过3秒;回流及手工焊接次数不大于3次。
- 7. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装,存放条件:温度+10~+35℃,湿度35~65%RH;需长期储存(超过半年)产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 8. 应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境,在焊接及清洗完成后,应对产品进行三防喷涂处理,以提高产品耐环境适应性能力。